

2009年7月30日

**2010年3月期 第1四半期
決算カンファレンスコール資料**

2010年3月期 第1四半期 業績概要（前年同期比）

（単位：億円）

	2009年3月期 第1四半期 (2008/4~2008/6)		2010年3月期 第1四半期 (2009/4~2009/6)		増減	
	金額	売上高比 (%)	金額	売上高比 (%)	金額	率 (%)
売上高	3,318	100.0	2,254	100.0	-1,064	-32.1
営業利益	280	8.4	-56	-2.5	-336	—
税引前四半期純利益	369	11.1	7	0.3	-362	-98.1
当社株主に帰属する 四半期純利益	220	6.6	-5	-0.2	-225	—
希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益(円)	115.82	—	-2.50	—	—	—
設備投資額	180	5.4	56	2.5	-124	-68.9
減価償却費	193	5.8	148	6.6	-45	-23.0
研究開発費	169	5.1	131	5.8	-38	-22.4

2010年3月期 第1四半期 決算要約（前年同期比）

1. 事業環境の悪化による収益の減少

部品事業

- ・デジタルコンシューマ機器、半導体製造装置、自動車向けをはじめ、需要は低水準で推移

機器事業

- ・国内での携帯電話端末の買い替え需要は鈍化、景気悪化の影響により米国での販売が低迷
- ・旧三洋の事業での販売モデル数の減少
- ・情報化投資の抑制による複合機の販売減

2. 米ドル・ユーロに対する円高の影響

		2009年3月期 第1四半期		2010年3月期 第1四半期	
平均為替レート		対ドル:105円	対ユーロ:163円	対ドル:97円	対ユーロ:133円
為替の変動による影響額 (前年同期比)	売上高	-208億円		約 -190億円	
	税引前 四半期純利益	-29億円		約 -55億円	

3. コスト削減の進展 前年同期比 約-390億円

- ・減価償却費:前年同期比 約-45億円
- ・諸経費(人件費含む):前年同期比 約-345億円

2010年3月期 第1四半期 業績概要（前四半期比）

（単位：億円）

	2009年3月期 第4四半期 (2009/1～2009/3)		2010年3月期 第1四半期 (2009/4～2009/6)		増 減	
	金 額	売上高比 (%)	金 額	売上高比 (%)	金 額	率 (%)
売 上 高	2,260	100.0	2,254	100.0	-6	-0.3
営 業 利 益	-238	—	-56	-2.5	+182	—
税引前四半期純利益	-264	—	7	0.3	+271	—
当社株主に帰属する 四半期純利益	-273	—	-5	-0.2	+268	—
設 備 投 資 額	78	3.5	56	2.5	-22	-28.2
減 価 償 却 費	219	9.7	148	6.6	-71	-32.3
研 究 開 発 費	145	6.4	131	5.8	-14	-9.4

2010年3月期 第1四半期 決算要約（前四半期比）

1. 想定を上回る部品需要の急速な回復

- ・デジタルコンシューマ機器、PC向けに需要が急回復
- ・半導体部品関連事業、電子デバイス関連事業が部品事業の増収を牽引

2. 営業利益の改善

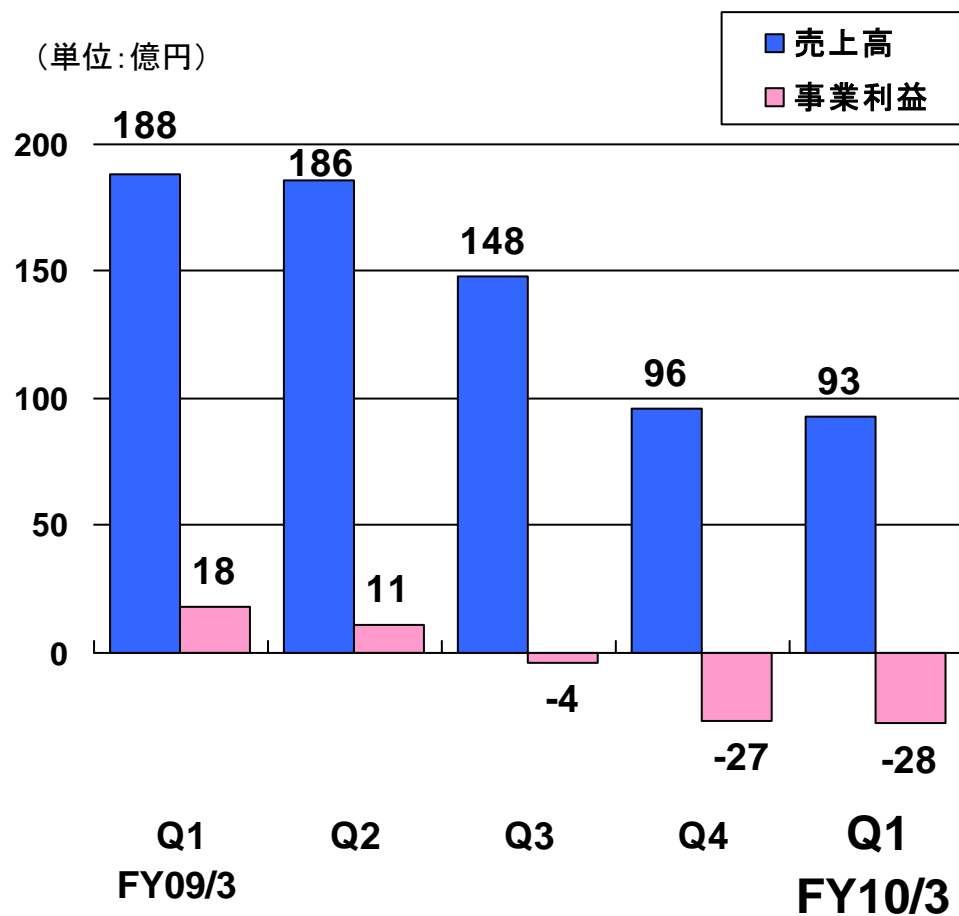
（単位：億円）

	2009年3月期 第4四半期	2010年3月期 第1四半期	増減額
営業利益	-238	-56	182
うち一時費用*	-75	—	75
一時費用を除く営業利益	-163	-56	107

*一時費用：「のれん」の減損、構造改革費用など

事業セグメント別四半期推移

ファインセラミック部品関連事業



前年同期比

- ・ 主要製品の需要減
(半導体製造装置用部品、自動車関連部品、デジタルコンシューマ機器用部品など)

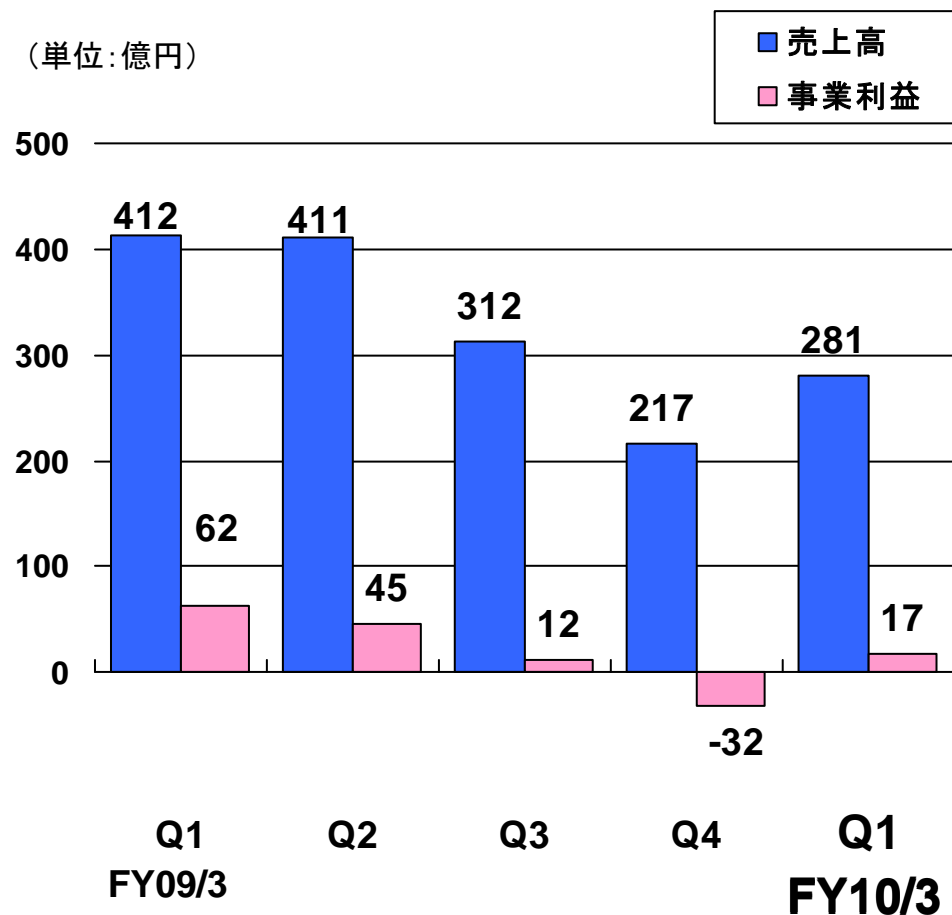
前四半期比

- ・ デジタルコンシューマ機器用部品は需要が回復
- ・ 半導体製造装置用部品、自動車関連部品などの需要低迷

事業セグメント別四半期推移

半導体部品関連事業

(単位:億円)



前年同期比

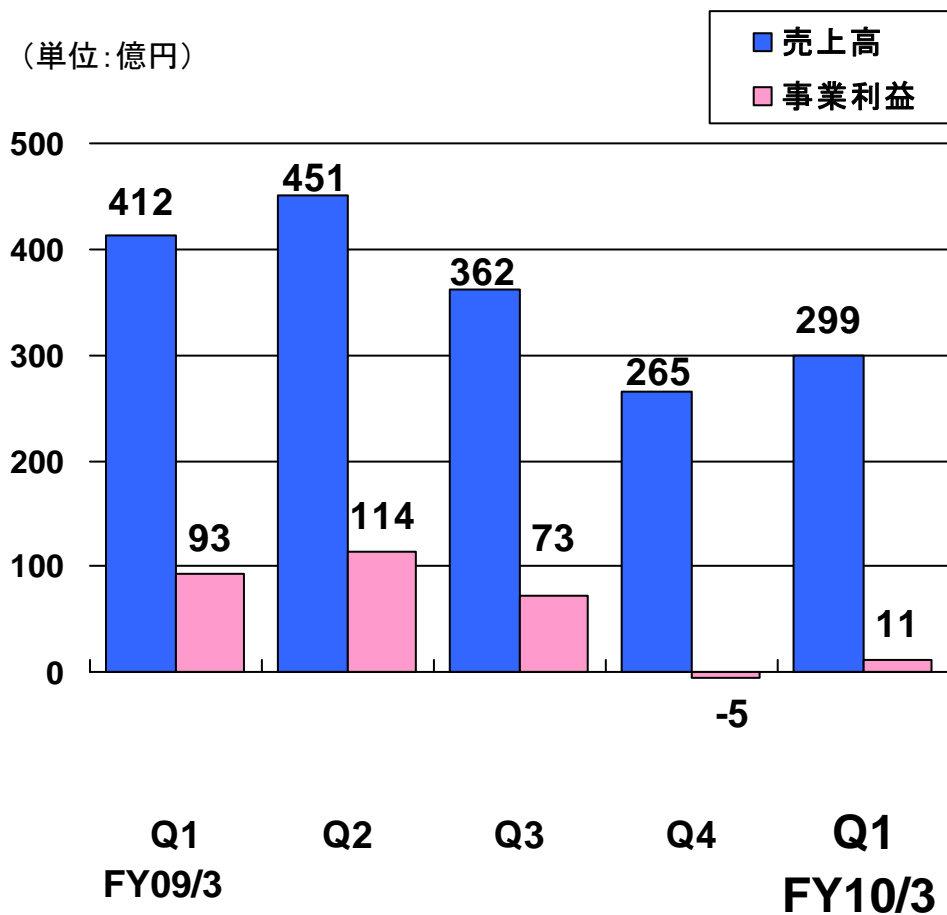
- ・ デジタルコンシューマ機器向けセラミックパッケージの需要減少
- ・ サーバー向け有機パッケージの需要減少

前四半期比

- ・ 携帯電話端末、デジタルカメラ向けにセラミックパッケージの需要が急回復
- ・ 携帯電話端末向けSiP基板の需要回復

事業セグメント別四半期推移

ファインセラミック応用品関連事業



前年同期比

- ・ 事業環境の悪化、円高の影響によりソーラーエネルギー事業が減速
- ・ 自動車業界の生産減少による切削工具の需要減

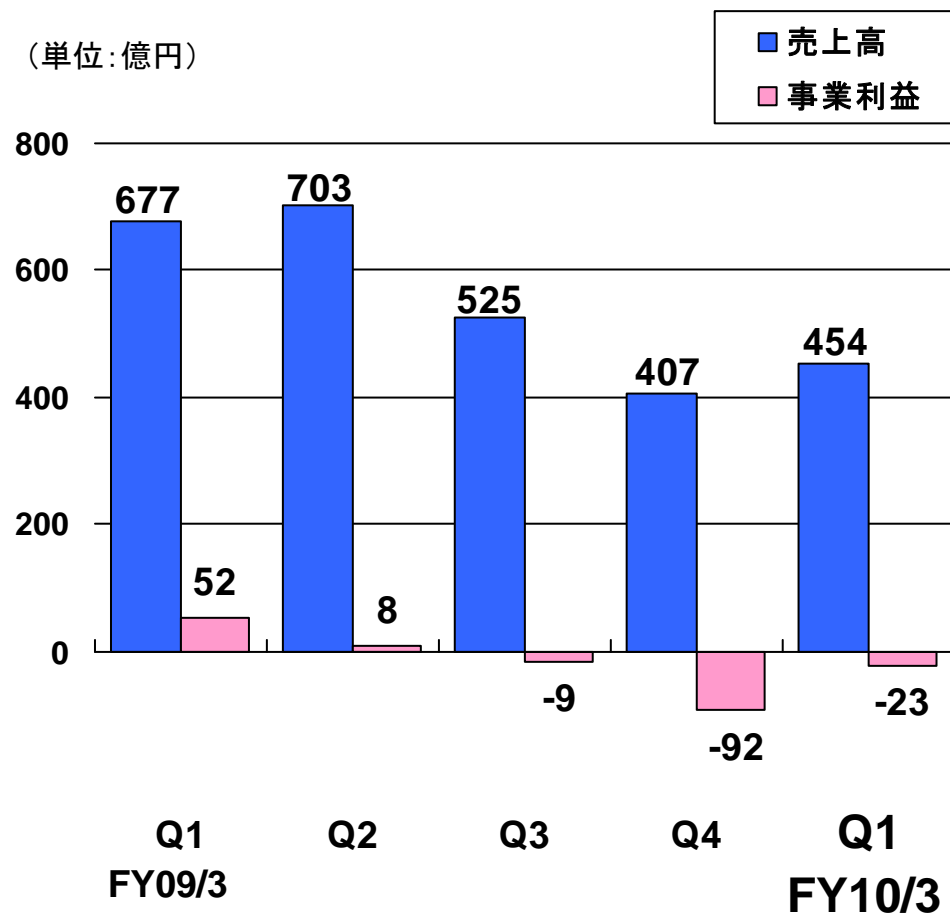
前四半期比

- ・ ソーラーエネルギー事業の売上拡大
- ・ 切削工具事業は依然として低水準で推移
- ・ 前四半期に約22億円の「のれん」の減損費用を計上

事業セグメント別四半期推移

電子デバイス関連事業

(単位: 億円)



前年同期比

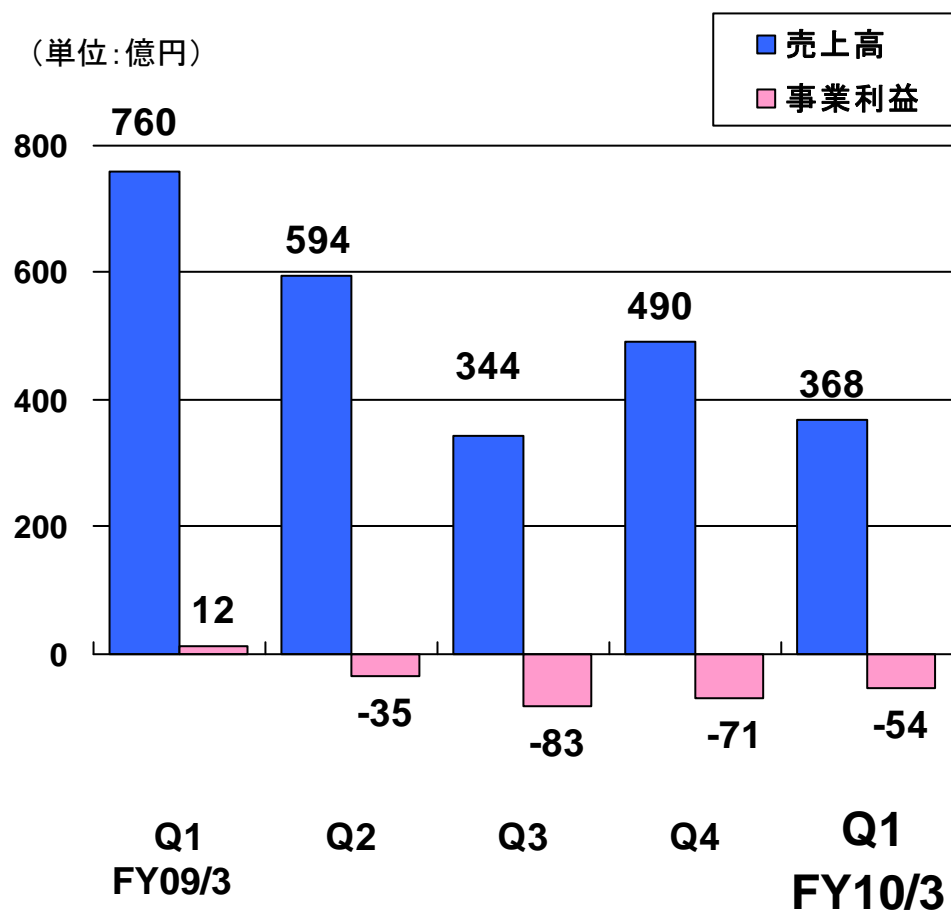
- デジタルコンシューマ機器やPC関連をはじめ、主要市場で水晶関連製品、コンデンサ、コネクタの需要が減少

前四半期比

- デジタルコンシューマ機器やPC関連向けに部品需要は急回復
- 需要増に伴う設備稼働率の上昇、コスト削減効果により事業損失は縮小
- 前四半期に構造改革費用など約30億円を計上

事業セグメント別四半期推移

通信機器関連事業



前年同期比

- ・ 割賦販売の影響により国内携帯電話端末の買換え需要が鈍化
- ・ 景気の低迷により海外携帯電話端末の需要は低迷

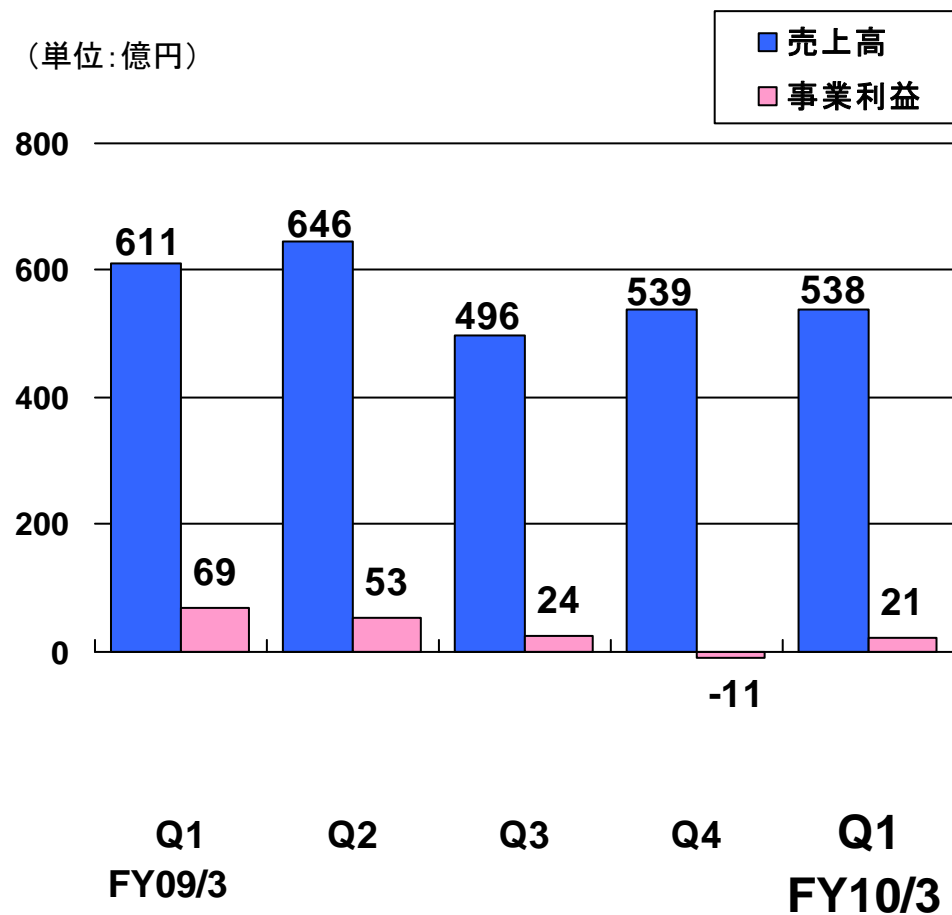
前四半期比

- ・ 基地局及び端末の数量減により売上は減少
- ・ 構造改革施によるコスト削減効果により事業損失は縮小
- ・ 前四半期に構造改革費用 約15億円を計上

事業セグメント別四半期推移

情報機器関連事業

(単位:億円)



前年同期比

- ・ 情報化投資抑制による需要減
- ・ 価格競争の激化及び円高の影響

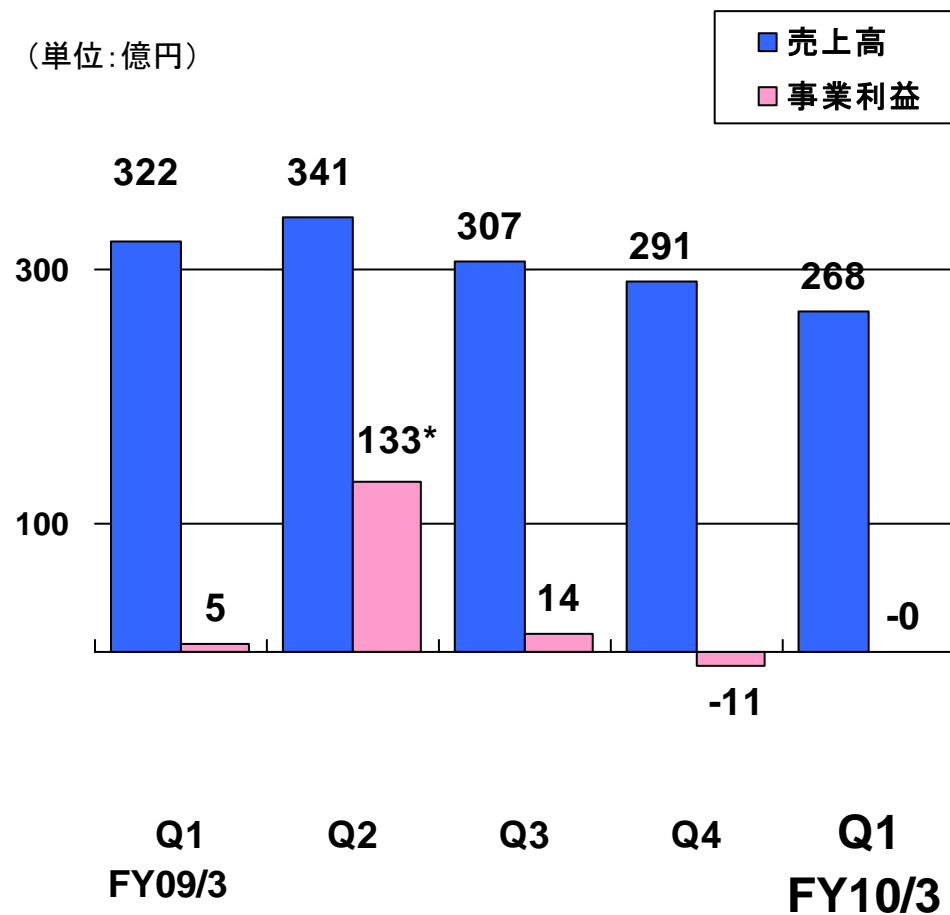
前四半期比

- ・ 需要低迷により売上は横ばい
- ・ 開発や生産の集約などによるコスト削減の進展により黒字化

事業セグメント別四半期推移

その他の事業

(単位:億円)



前年同期比

- ・ 各種電子機器向け電子部品材料の需要減
- ・ 通信インフラ関連の投資抑制による通信エンジニアリング事業の低迷

前四半期比

- ・ 京セラコミュニケーションシステム(株)の減収
- ・ 京セラケミカルの収益改善
- ・ 前四半期に「のれん」の減損費用約12億円を計上

* 資産売却益約105億円を含む

2010年3月期 業績予想

(2009年4月27日に公表の通期業績予想から変更なし)

(単位:億円)

	2009年3月期 実績		2010年3月期 予想		増減率 (%)
	金額	売上高比 (%)	金額	売上高比 (%)	
売上高	11,286	100.0	10,400	100.0	-7.8
営業利益	434	3.8	440	4.2	1.3
税引前当期純利益	560	5.0	570	5.5	1.8
当社株主に帰属する当期純利益	295	2.6	340	3.3	15.2
希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(円)	157.23	—	185.26	—	17.8
設備投資額	631	5.6	430	4.1	-31.8
減価償却費	838	7.4	680	6.5	-18.8
研究開発費	659	5.8	580	5.6	-12.0
平均為替レート	対ドル:101円	対ユーロ:143円	対ドル:92円	対ユーロ:123円	
為替の変動による影響額(前期比)	売上高	-910億円		-780億円	
	税引前当期純利益	-230億円		-240億円	

(注)2010年3月期 予想の希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、2010年3月期第1四半期の希薄化後の期中平均発行済株式数を用いて算出しています。
最終ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください

2010年3月期 事業セグメント別連結売上高

(2009年4月27日に公表の通期業績予想より変更なし)

(単位:億円)

■ 事業セグメント	2009年3月期 実績		2010年3月期 予想		増減率 (%)
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
■ ファインセラミック部品関連事業	617	5.4	500	4.8	-19.0
■ 半導体部品関連事業	1,351	12.0	1,100	10.6	-18.6
■ ファインセラミック応用品関連事業	1,489	13.2	1,580	15.2	6.1
■ 電子デバイス関連事業	2,313	20.5	1,850	17.8	-20.0
部品事業計	5,771	51.1	5,030	48.4	-12.8
■ 通信機器関連事業	2,188	19.4	2,000	19.2	-8.6
■ 情報機器関連事業	2,293	20.3	2,340	22.5	2.1
機器事業計	4,481	39.7	4,340	41.7	-3.1
■ その他の事業	1,260	11.2	1,230	11.8	-2.4
調整及び消去	-226	-2.0	-200	-1.9	—
売上高計	11,286	100.0	10,400	100.0	-7.8

2010年3月期 事業セグメント別連結事業利益

(2009年4月27日に公表の通期業績予想より変更なし)

(単位:億円)

■事業セグメント	2009年3月期実績		2010年3月期予想		増減率(%)
	金額	売上高比(%)	金額	売上高比(%)	
■ ファインセラミック部品関連事業	-2	—	0	—	—
■ 半導体部品関連事業	87	6.4	40	3.6	-53.9
■ ファインセラミック応用品関連事業	275	18.4	180	11.4	-34.5
■ 電子デバイス関連事業	-41	—	20	1.1	—
部品事業計	318	5.5	240	4.8	-24.6
■ 通信機器関連事業	-177	—	-60	—	—
■ 情報機器関連事業	135	5.9	110	4.7	-18.5
機器事業計	-42	—	50	1.2	—
■ その他の事業	141	11.2	40	3.3	-71.6
事業利益計	417	3.7	330	3.2	-20.9
本社部門損益等	143	—	240	—	68.3
税引前当期純利益	560	5.0	570	5.5	1.8

注 記

- 各項目の金額は億円単位で四捨五入しています。
 - 各比率については、百万円単位で比較した際の比率を記載しています。
 - 「当社株主に帰属する当期純利益」及び「当社株主に帰属する四半期純利益」は2009年3月期までの「当期純利益」及び「四半期純利益」と同じ内容です。
-

将来予想に関する注意事項

この資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義される「将来予想に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所信を表明したものであります。これらの将来予想に関する記述は、既知及び未知のリスク、不確実な要因並びにその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は以下のものを含みますが、これらに限られるものではありません。(1)当社が関連する市場における経済状況(主に、日本、北米、欧州並びにアジア(特に中国))。(2)中国における経済・政治・法律面での条件の予測し得ない変化。(3)競争の激しいセラミック、半導体部品及び電子部品市場において当社が、革新的な製品を開発・生産し、品質・納期を含めて、顧客の要求に沿った先進技術を投入する能力の不確実性。(4)生産高や業績に影響を与える社外委託工程や自社内製造過程で生じる遅れや不具合の発生。(5)円高、政治・経済情勢、売掛金回収リスク、製品の価格競争力の低下、輸送経費の増大、海外事業への人材配置・管理の問題、知的財産権の保護の不十分性など、輸出に影響する可能性がある要素。(6)売上高の相当な部分を構成している通貨(特に米ドル及びユーロ)の対円為替相場の変動。(7)当社顧客の財政状態の悪化による売掛債権の回収リスク。(8)エンジニアリング・技術部門での熟練労働者の確保の不確実性。(9)機密保持及び特許権の保護の確保が不十分である事態。(10)製品を製造・販売する為に必要となるライセンスの継続的確保の不確実性。(11)今後の取り組み及び現在進行中の研究開発が期待される成果を生み出さない事態。(12)買収した会社や取得した資産に関連して想定以上の統合費用がかかり、期待される収益又は事業機会が得られない事態。(13)テロ行為、疾病の発生など、当社の市場やサプライチェーンに悪影響を与える要素。(14)製造施設その他主要な事業関連施設が存在する地域における地震などの自然災害の発生。(15)国内外の環境規制強化に伴う当社の賠償責任や遵守義務の増大。(16)保有する有価証券及びその他の資産の時価の変動、減損処理の発生。(17)会計基準の変更。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財務状況は、これらの将来予想に関する記述に明示又は包含される将来の業績、事業活動、展開又は財務状況と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。